

高信頼性部品のダイナミックバーンイン

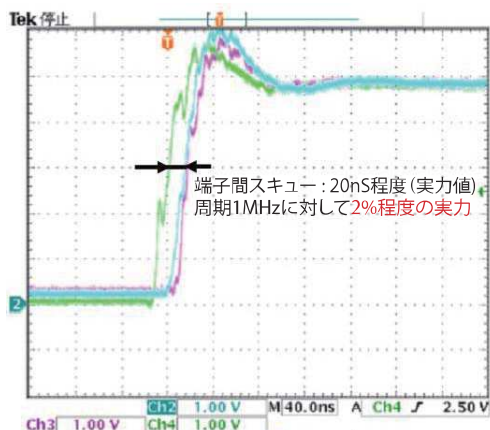
ダイナミックバーンインは、LSIの内部回路を動作させ、温度と電圧の負荷をかけることにより、初期不良を低減させる最も有効な試験方法です。OKIエンジニアリングでは大容量化したFPGA等に対応できるダイナミックバーンイン装置を開発いたしました。宇宙・防衛・産業機器・自動車等の高信頼性分野で使用されるデバイスのスクリーニングに、柔軟、短納期、低価格で対応いたします。

ダイナミックバーンイン装置の特徴

- ◆ 高いテストカバレッジ : 最大20Mステップ
(信号の変化点を1ステップ)
- ◆ 豊富な対応可能テストパターンフォーマット : VCD, WGL, STILに対応
- ◆ 柔軟なコンカレントテスト性 : 最大4テストパターンを並行して試験可能
- ◆ 小さな端子間スキュー : 約20ns@1MHz
- ◆ 大きな信号数 : 256信号線
- ◆ 最大動作周波数 : 5MHz
- ◆ 綺麗な入力波形 : オーバー/アンダーシュート約0.2V
- ◆ 幅広い電源/入力電圧 : VccCore(2.25V~6.00V), VccIO(3.00V~6.00V)
VIH(2.00V~5.5V), VIL(0.4V以下)



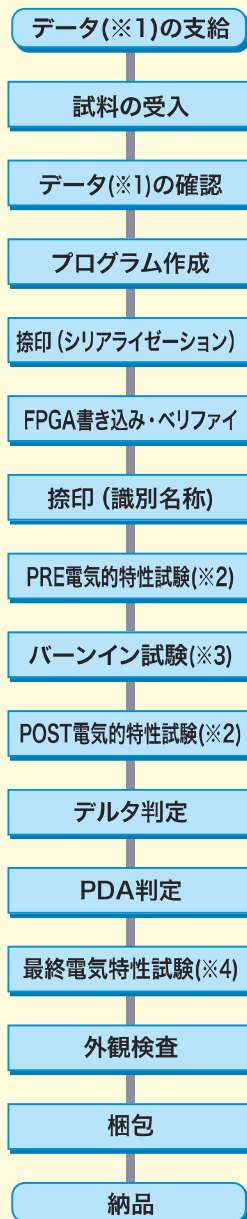
入力波形のオーバー/アンダーシュート約0.2V



端子間スキュー約20ns@1MHz

FPGAのスクリーニングフロー

FPGAの実績例:
RP1280A, RT14100A, RT54SX32, RT54SX72等



リードタイム: 2週間~3週間 (試験条件に依る)
 ※1: 書き込み, シミュレーションデータ
 ※2: 常温
 ※3: Static / Dynamic (+125°C, 168hr/240hr)
 ※4: 低温(-55°C), 高温(+125°C)